

第 25 回 電子デバイス実装研究委員会プログラム

日時： 2019 年 5 月 15 日(水) 10:30～16:30

場所：日本橋ライフサイエンスビルディング 9 階 911-913 会議室（東京都中央区）

時 間	題 目	講 演 者
10:30～ 12:00	司会 山部 光治 ((株)東芝)	
	『フラックス洗浄の最前線』 (45 分)	○石原 慧太 (化研テック(株))
	『高機能脱Auボンディングワイヤの開発』 (45 分)	○宇野 智裕、小山田哲哉 (日本製鉄(株))
12:00～ 13:00	昼 食 休 憩	
13:00～ 13:10	委 員 会 議 事	
13:10～ 14:40	司会 福本 信次 (大阪大学)	
	『MID用Cuペースト』 (45 分)	○江尻 芳則(日立化成(株))
	『フレキシブルエレクトロニクスを志向した 電気接続技術』 (45 分)	○吉良 敦史、三井 亮介、佐藤 隼也、 松尾 幸祐、中島伸一郎 (日本航空電子工業(株))
14:40～ 14:50	休 憩	
14:50～ 16:20	司会 尾形 繁行 (長野沖電気(株))	
	『銀ナノ粒子をシード層に用いた銅配線 形成技術』 (45 分)	○白髪 潤 (DIC(株))
	『電磁誘導加熱方式を用いた新規はんだ 付け工法の開発』 (45分)	杉山 和弘、○菅 洋一郎 (株)ワンダーフューチャーコーポレーション)
16:20～ 16:30	表 彰 式	

()内時間は、質疑応答時間を含む

※ プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。